

# 「KNITE<sup>®</sup> プロセス」

## New Electroless Ultra Thin Ni/Pd/Au Plating Processes

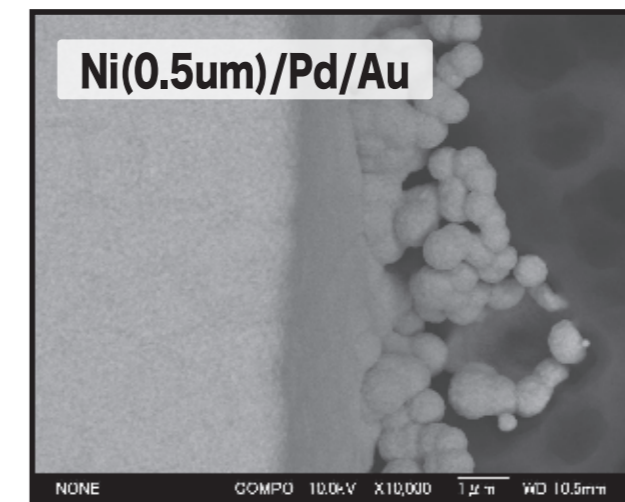
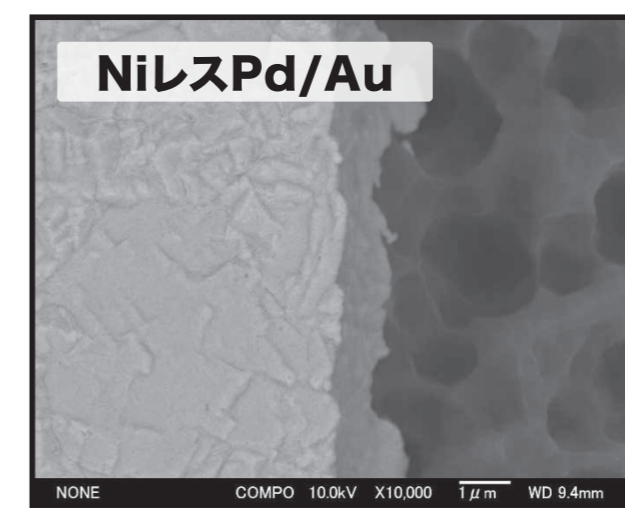
### 特長

- 微細・狭ピッチCu配線へのめっき皮膜形成を実現します。
- めっき工程における下地金属のボイド発生を抑制します。
- 優れたはんだ接合特性、ワイヤーボンディング特性を両立できます。

### めっき工程

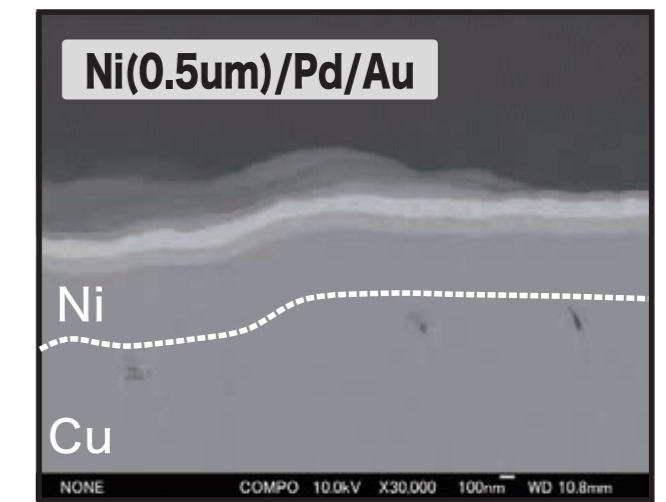
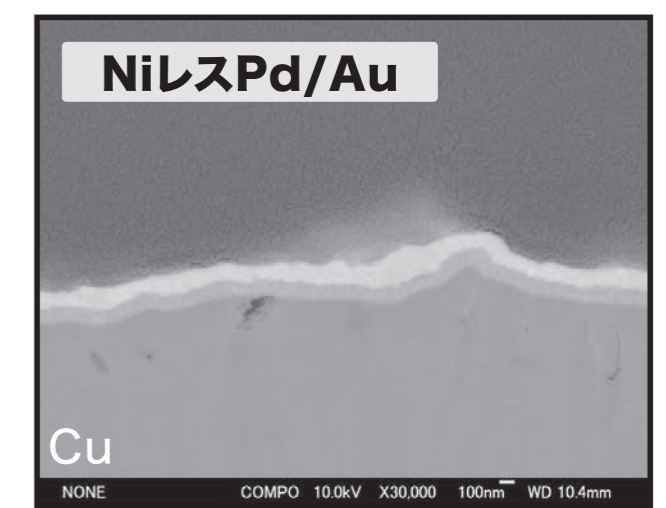
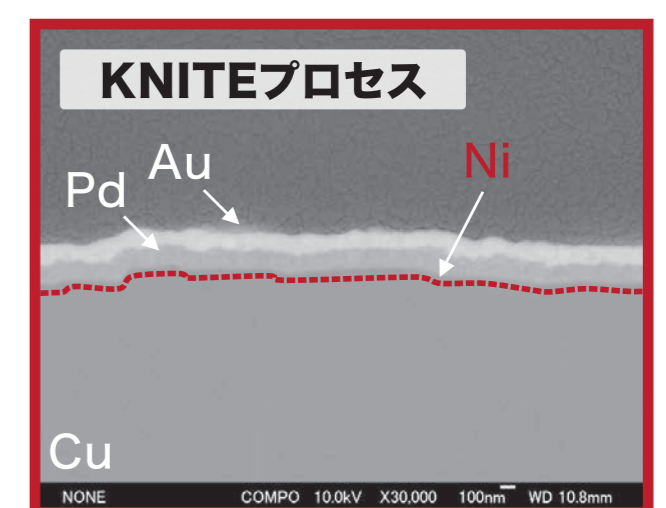
めっき工程	KNITEプロセス	NiレスPd/Au	Ni/Pd/Au
脱脂処理	○	○	○
エッチング処理	○	○	○
スマット除去処理	○	○	○
Pd触媒付与処理	—	○	○
無電解Niめっき	○	—	○
無電解Pdめっき	○	○	○
無電解Auめっき	○	○	○
工程数	<b>6工程</b>	6工程	7工程

### 選択析出性

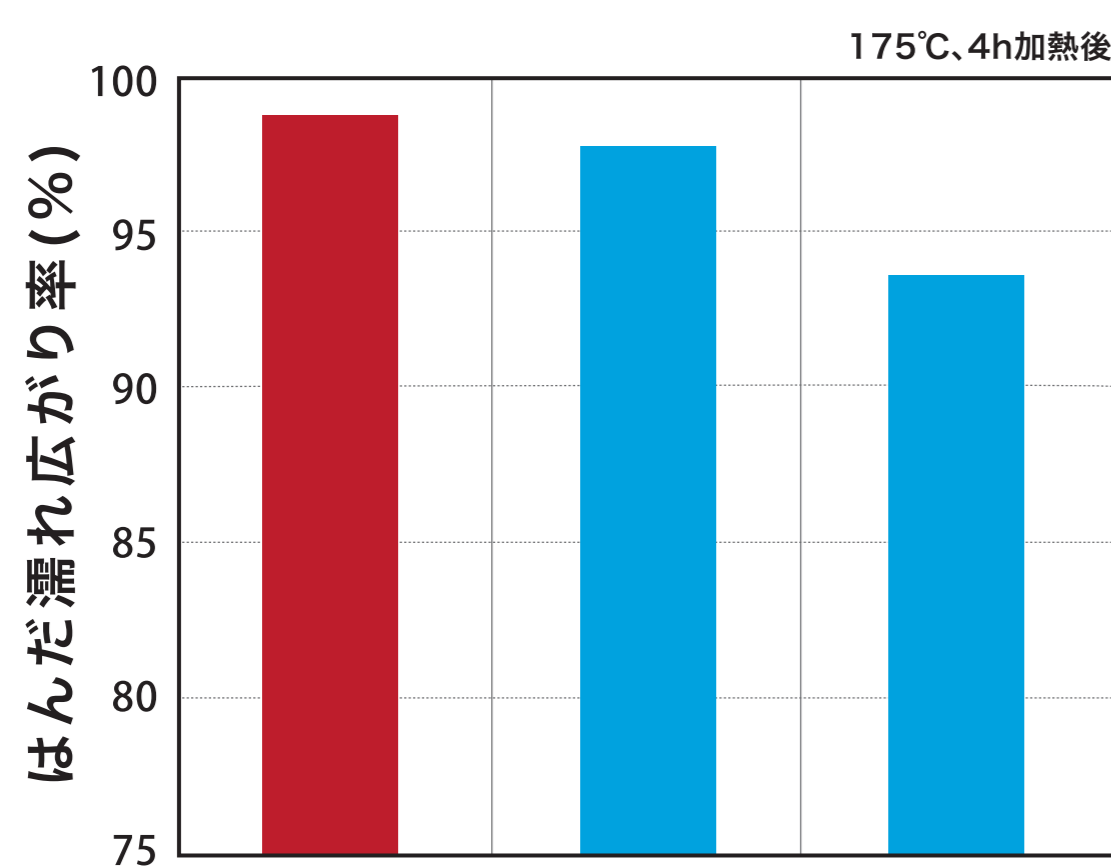


L/S=30μm

### めっき皮膜断面



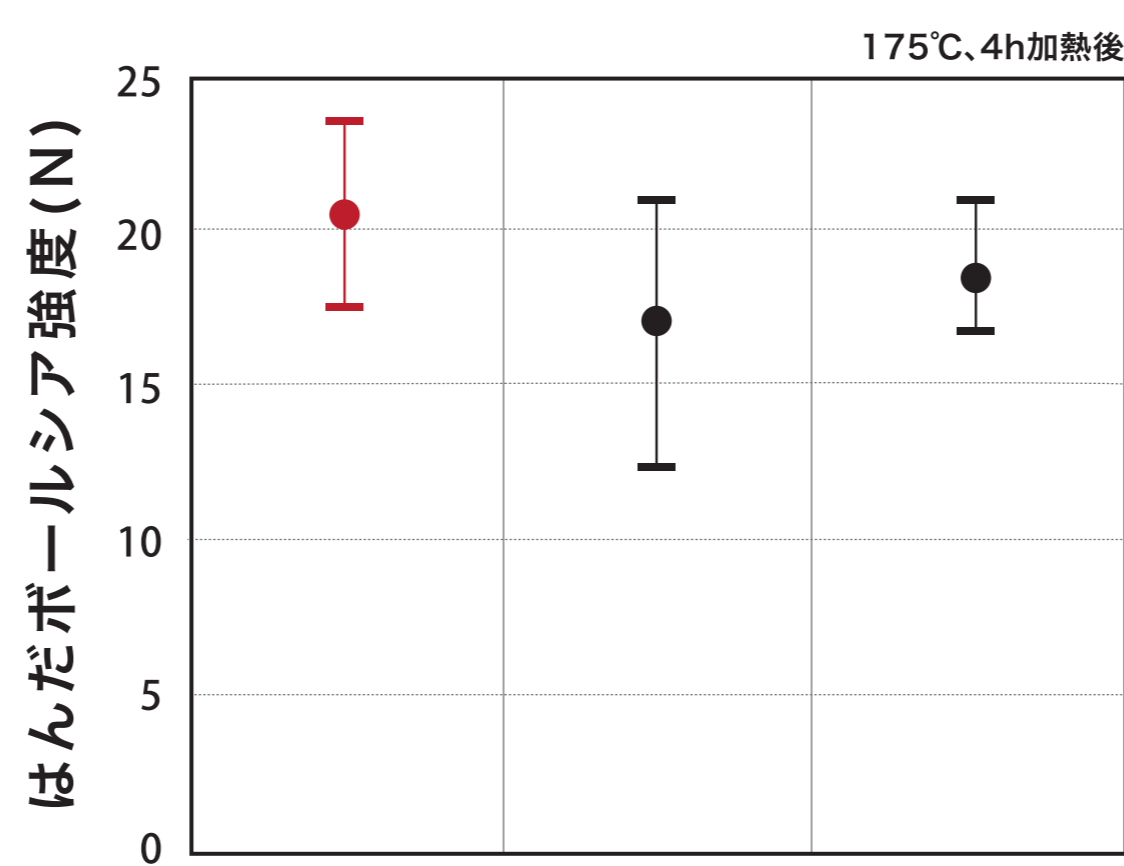
### はんだ濡れ広がり特性



KNITEプロセス NiレスPd/Au Ni/Pd/Au

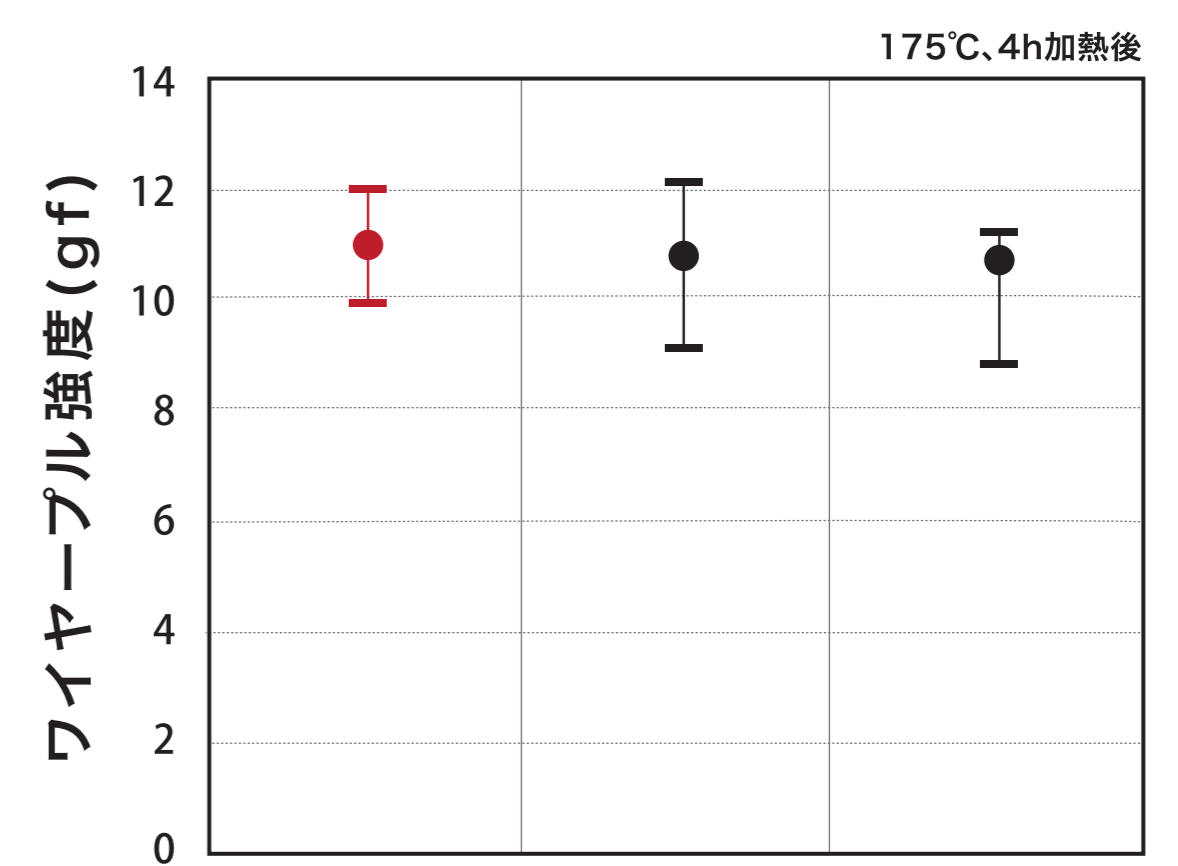
KNITEプロセス ⇒ Ni 0.01μm/Pd 0.1μm/Au 0.1μm  
 NiレスPd / Au ⇒ Pd 0.1μm/Au 0.1μm  
 Ni/Pd/Au ⇒ Ni 5μm/Pd 0.1μm/Au 0.1μm

### はんだ接合特性



KNITEプロセス NiレスPd/Au Ni/Pd/Au

### Auワイヤーボンディング特性



KNITEプロセス NiレスPd/Au Ni/Pd/Au

